

Lasertec News 25

株 主 通 信 第 5 9 期 (2020年7月1日~2021年6月30日)



中期経営計画「フェーズ3+」始動

Lasertec

証券コード6920

Lasertec



2021年6月期(当期)は、前期に引き続き、売上、利益、受注、受注残、すべての面で過去最高を更新しました。あらゆる用途で拡大を続ける半導体需要と、最先端の半導体製造ライン向けで普及が進むEUVリソグラフィが追い風となり、中期経営計画フェーズ3の3年間で大きく飛躍することができました。

代表取締役社長

岡林 理

Q1

当期の業績についてどう評価されますか。市場環境と併せてお話しください。

A1

EUV関連の製品が大きく成長し、前期に続いて、売上、利益ともに過去最高を更新できました。

最先端の半導体製造ライン向けでEUV(極端紫外線)リソグラフィの導入がさらに進み、EUVに関連した製品が業績に大きく貢献しました。背景としては、まずコロナ禍で広がったリモートワークやオンライン会議の利用が挙げられます。皆さまがお使いになるパソコンの需要が増えましたし、通信やデータ処理のインフラとしてデータセンターで使われるサーバーの需要も拡大しました。移动通信の分野でも5G(第5世代移动通信システム)の携帯電話や通信設備が普及し始めています。これらは最先端の半導体を必要としますので、半導体デバイス

メーカー各社も積極的に投資を行っており、当社の事業環境はとても良い状況が続いています。

当期の業績としましては、売上高が702億48百万円(前連結会計年度比65.0%増)、営業利益が260億74百万円(同73.1%増)、経常利益が264億38百万円(同

74.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が192億50百万円(同77.9%増)となりました。さらに、受注高は1,129億4百万円(同40.8%増)、期末受注残高は1,358億19百万円(同45.8%増)となり、すべての面で過去最高額を更新できました。

Q2

当期で中期経営計画フェーズ3が終了しましたが、振り返ってどのように評価されますか。

A2

フェーズ2までにまいてきた種が芽吹き、果実が実り始めた3年間でした。EUV関連製品はまだまだ大きく育つポテンシャルを秘めていますし、ウェハ関連製品も着実に成長していて今後が楽しみです。

以前から新規事業として取り組んできたEUV関連やウェハ関連の製品が大きく業績に貢献し始めて、フェーズ2とフェーズ3の各最終年度(2018年6月期と2021年6月期)を比べると、売上が3.3倍、営業利益が4.6倍と事業を大きく成長させることができました。個別の製品では、EUVマスクとDUVマスクの両方を検査できる

「MATRICS X8ULTRA」が最先端のロジックデバイスメーカーやDRAMメモリーメーカーのお客さまから大変ご好評をいただき、当社を成長させる原動力になりました。

あらためてフェーズ3の期間を振り返りますと、当社にとって大事な新製品の発表が毎年ありました(下表参照)。

発表年月	新製品
2018年11月	マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置「MAGICS M9650/M9651」
2019年9月	アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A150」
2020年1月	ハイブリッドレーザーマイクロスコープ「OPTELCICS HYBRID+」
2021年6月	マスクエッジ検査装置「MZ100」

連結業績ハイライト

売上高

70,248百万円

前連結会計
年度比

65.0% ↑

受注高

112,904百万円

前連結会計
年度比

40.8% ↑

営業利益

26,074百万円

前連結会計
年度比

73.1% ↑

当期純利益*

19,250百万円

前連結会計
年度比

77.9% ↑

※親会社株主に帰属する当期純利益

当社のマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 MAGICSシリーズは、長年にわたり業界標準機としてご愛顧いただいてきました。その最新機種となる「M9650/M9651」は、今後も進むEUVマスクブランクス、DUVマスクブランクスの高品質化にさらに寄与してまいります。

アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A150」は、当社が世界で初めて製品化に成功した、EUV光を用いたEUVマスク検査装置です。現在はDUV光を用いた「MATRICS X8ULTRA」によるEUVマスク検査が主流ですが、今後半導体の微細化が進んでいくと、より高感度でEUVマスクに特有の転写性位相欠陥が検出できる「ACTIS A150」が活躍する場面が広がりますので、業績への大きな貢献を期待しています。

マスクエッジ検査装置「MZ100」は、従来管理されていなかったマスクエッジ部の欠陥検査を行うことで、EUVおよびDUVマスク製造プロセスの歩留まり向上や高品質化に寄与することを目的とした新機軸の製品です。

今後ともお客さまのご要望に真摯にお応えして、当社独自のソリューションを提供してまいります。

ハイブリッドレーザーマイクロスコープ「OPTELICS HYBRID+」はレーザー顕微鏡の最新機種です。当社は長年レーザー顕微鏡を取り扱い、これまでも多様な産業の研究開発や品質保証の部門で使用されてきました。本製品は検査に顕微鏡が用いられる研究開発と、専用の検査装置が用いられる量産プロセスの隙間をターゲットにして、自動搬送および自動測定・自動検査の機能を向上させた製品です。研究開発から量産プロセスへのスムーズな移行をサポートします。

実はこれら以外にも对外発表をしていないプロトタイプ製品もいくつかあるのですが、それらすべてがお客さまからご要望をいただいて開発を進めているものです。フェーズ3の期間には当社がビジョンとする「世界中のお客さまから真っ先に声をかけていただける会社」に近づけたようで、大変うれしく思っております。

Q3

2022年6月期(今期)からフェーズ3+が始まります。フェーズ3+(プラス)の目標を教えてください。

A3

前フェーズ3から取り組んでいる施策をさらに強力に推進していくために、フェーズ3+と名付けました。中長期的に成長機会を最大限に捉えるために、経営基盤の強化に注力しお客さまのご要望にお応えしてまいります。

フェーズ3+と名付けた意図に通じるのですが、フェーズ3から取り組んでいる施策のさらなる推進が一番の課題です。

当社のお客さまは主に半導体産業ですが、半導体不足といわれるほど底堅い需要を受けて、足元では設備投資が非常に活発です。これは前段で触れたように、リモート

ワークやオンライン会議を支えるデータセンターで使われるサーバーを中心とするHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)や、5G向けの需要が牽引しています。そのほかにもAI(人工知能)、IoT(さまざまなものがインターネットにつながる)、ADAS(先進運転支援システム)など幅広い用途で半導体が使われるようになっており、

将来にわたって半導体需要が拡大すると予想されています。加えて、米中摩擦と相まって地政学リスクが懸念され始め、米国、EU、日本では半導体工場の域内新設に向けた企業誘致や補助金の議論が活発になっています。半導体デバイスメーカーはこれまで特定の国で集中投資を行っていましたが、今後はさまざまな国での分散投資が進むと見込まれております。分散することで必要な装置数や投資額が増えますので、半導体製造装置メーカーにはプラス要因です。また、最先端の半導体プロセスには従来以上の投資額が必要で、これも最先端分野に注力する当社には追い風となっています。

このような事業環境の中、当社の課題は、お客さまからの難易度が高いご要望に応え、事業投資拡大のペースにしっかりとついていくことです。そのためには前フェーズ3から強化に取り組んでいる研究開発ならびに装置立ち上げ体制、サプライチェーン、グローバル・サービス体制をさらにレベルアップする必要があり、フェーズ3+でも「経営基盤の強化」を最重要課題として取り上げています。

一方で、当社が持続的な成長を実現するには新規事業や新製品が欠かせませんので、「成長機会の追求」も引

最後に株主さまへメッセージをお願いいたします。

おかげさまで、5期連続で過去最高の業績を更新することができました。今期から始まる中期経営計画フェーズ3+で直面している課題を一言で表現しますと、「事業成長のジレンマ」です。好調な事業環境に支えられ、新規事業も芽吹いて成長機会にも恵まれておりますが、チャンスを着実に業績に結び付けていくた



き続き課題として挙げています。これまでも顕微鏡ビジネスをアンテナとして多様な産業でビジネスチャンスをつえ、SiCウェハ欠陥検査/レビュー装置「SICA88」や電気化学反応可視化コンフォーカルシステム「ECCS B310」（リチウムイオン電池の電気化学反応を観察・計測するシステム）などの新規事業を創出してきました。今後も現在主力とするマスクブランクス/マスク検査の領域にとどまらず、当社が強みを発揮できお客さま、ひいては世の中に貢献できる分野とアプリケーションを積極的に探し、成長に結び付けてまいります。

めには現在の会社組織では不十分です。今後とも株主の皆さまのご期待に応えて事業を成長させるべく、国内外で優れた人材の獲得と育成を加速して、フェーズ3+の期間に組織を飛躍的に強化してまいります。株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

中期経営計画「フェーズ3+」始動

中期経営計画の概要

当社は、合計15カ年の中期経営計画を推進しており、2021年6月期はフェーズ3(2018年7月～2021年6月)の最終年度でした。フェーズ3の期間には、ロジックファウンドリによるEUV(極端紫外線)リソグラフィの導入が本格化し、フェーズ2までに種まきをしたEUV関連製品の市場が急拡大して、当社の成長に大きく寄与し始めました。

フェーズ3+

2021年7月～2024年6月

2022年6月期からの3カ年はフェーズ3+と位置付け、右記の取り組みを実行します。

フェーズ3+の期間では、IoT(さまざまなものがインターネットにつながる)、データセンター、AI(人工知能)、ADAS(先進運転支援システム)などの技術革新が進み、ますます半導体需要の裾野が広がると見込まれています。また米国、EU、日本では、半導体工場の域内新設に向けた企業誘致や補助金の議論が活発になされており、半導体サプライチェーンの分散化と強化が試みられています。今年7月にSEMI*が発表した世界半導体製造装置の市場予測では、半導体デバイスメーカーの積極的な投資により前工程と後工程の両方で市場拡大が続き、半導体製造装置の世界販売額は2021年に953億米ドル、2022年には過去最高額の1,000億米ドルに達すると予想されています。

*SEMI: エレクトロニクス設計および製造サプライチェーンの業界団体(米国カリフォルニア州)



携帯・5G/IoT

利便性の追求



データセンター

膨大な量のデータ処理



AI

ビッグデータや画像の解析



自動車

EV化と自動運転の広がり

このような状況下で、当社は中長期的に成長機会を最大限に捉えるために、フェーズ3から取り組んでいる施策をさらに強力に推進し、経営基盤の強化に注力してまいります。

2つの重点取り組み

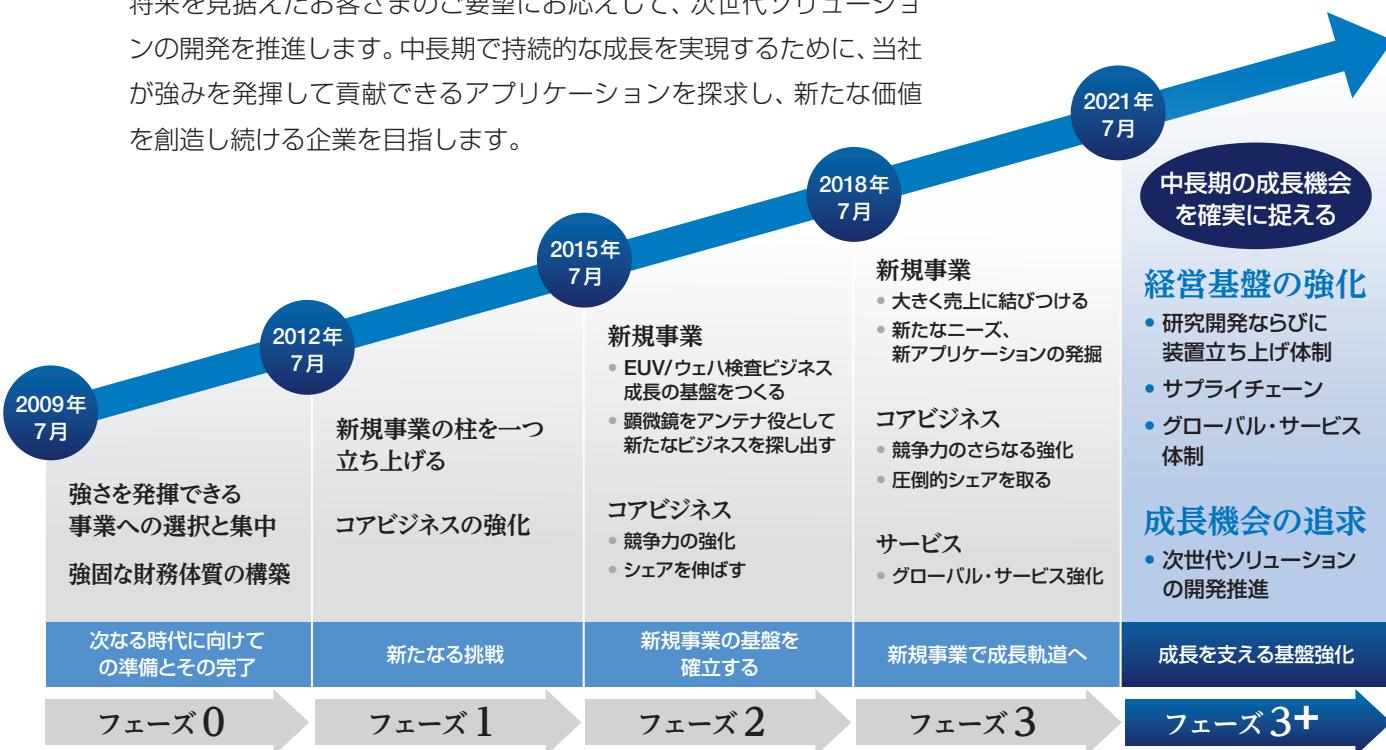
1 経営基盤の強化

お客さまのご要望に応えるため、事業全般の体制強化に取り組めます。

- 世の中になく価値、最先端のソリューションを提供するための、研究開発ならびに装置立ち上げ体制の強化
- 各製品需要を満たすための、サプライチェーンの強化
- 納品後に当社製品を安心してお使いいただくための、グローバル・サービス体制の強化

2 成長機会の追求

将来を見据えたお客さまのご要望にお応えして、次世代ソリューションの開発を推進します。中長期で持続的な成長を実現するために、当社が強みを発揮して貢献できるアプリケーションを探求し、新たな価値を創造し続ける企業を目指します。



基本方針

当社の強さが発揮でき、我々が成長できる分野に経営資源を集中する

2021
3/30

インテル コーポレーションから「プリファード・クオリティー・サプライヤー (PQS)賞」を受賞

PQS賞はたゆまぬ努力で品質を改善し、インテルの高い要求を上回るパフォーマンスを継続的に実現したサプライヤーに贈られるもので、2020年度は26社(全サプライヤー数千社中)が受賞しました。当社がこの賞を受賞するのは初となります。

2021
3/31

「High-Growth Companies Asia-Pacific 2021」入賞

Financial Times (英国)、日本経済新聞、Statista (ドイツ) が共同で調査を行ったアジア太平洋地域の急成長企業ランキングにおいて、全500社中279位に初入賞しました。当調査は、アジア太平洋地域13カ国、100万社以上の企業を対象とするもので、2016年～2019年の売上高(当社売上高は2017～2020年度)の年平均成長率上位500社が選ばれました。

2021
4/8

「デロイト 2020年アジア太平洋地域テクノロジーFast500」431位

テクノロジーFast500は、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドが北米・欧州・アジア太平洋地域のTMT(テクノロジー、メディア、通信)業界を対象に毎年実施しているランキングプログラムです。アジア太平洋地域では、直近3決算期の売上高成長率によって上位500社(上場、未上場問わず)が選定されました。当社は成長率100.3%(2018～2020年度)で431位となり、2003年以来2度目の受賞となりました。

2021
6/28

マスクエッジ検査装置「MZ(エムジー)100」

先端半導体向けEUVおよびDUVフォトマスクのエッジ部(外縁部)における高感度検査、レビュー、計測を可能にした装置です。半導体デバイス市場では5Gや高性能コンピューティング向けをはじめとする半導体の需要が増え続けています。これにより半導体デバイス製造工程では微細化による性能向上と、より高品質なマスクブランクス*1やフォトマスク*2の供給が求められています。「MZ100」は従来管理されていなかったマスクエッジ部の側面、傾斜部の欠陥検査を行うことで、フォトマスク製造工程の歩留まり改善やマスクブランクスおよびフォトマスクの高品質化に寄与します。



半導体関連の基本情報に関しては当社Webサイト「個人投資家の皆さまへ」で詳しくご紹介
<https://www.lasertec.co.jp/ir/individuals/>



※1 マスクブランクス：フォトマスク作製のガラス基板材料。薄い金属でできた遮光膜でおおわれている。

※2 フォトマスク：マスクブランクスに回路パターンを1層分形成したもの。露光でウェハに回路パターンを転写する際の原版。



公式Webサイトをリニューアルしました！

今回のリニューアルでは、IRページをより見やすくするとともに、サステナビリティに関する情報を拡充しました。株主の皆さまに最新IRニュースをいち早くお届けするために、「IRメール配信サービス」も開始いたしました。本サービスはメールアドレスをご登録いただいた方に、最新のIRニュースをお届けする無料配信サービスです。ぜひご利用ください。

<https://www.lasertec.co.jp/ir/>



<https://www.lasertec.co.jp/ir/mail.html>



企業ホームページ
最優秀サイト
2020
日興アイ・アール
総合ランキング



連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (2021年6月30日)	前連結会計年度 (2020年6月30日)	科目	当連結会計年度 (2021年6月30日)	前連結会計年度 (2020年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	101,725	70,002	流動負債	62,984	42,058
			固定負債	552	559
固定資産	16,999	11,791	負債合計	63,537	42,618
資産合計	118,725	81,794	純資産の部		
			株主資本	54,059	39,047
			① 純資産合計	55,188	39,175
			負債純資産合計	118,725	81,794

連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)	前連結会計年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)
② 売上高	70,248	42,572
売上原価	33,296	19,581
売上総利益	36,952	22,991
販売費及び一般管理費	10,878	7,929
② 営業利益	26,074	15,062
② 経常利益	26,438	15,115
② 親会社株主に帰属する当期純利益	19,250	10,823

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日)	前連結会計年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)
③ 営業活動による キャッシュ・フロー	10,488	16,486
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 3,703	△ 2,038
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 4,242	△ 2,800
現金及び現金同等物の 期首残高	24,660	13,120
現金及び現金同等物の 期末残高	27,849	24,660

決算のポイント

① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は551億88百万円となりました。自己資本比率は46.5%で、引き続き財務の健全性を維持しています。

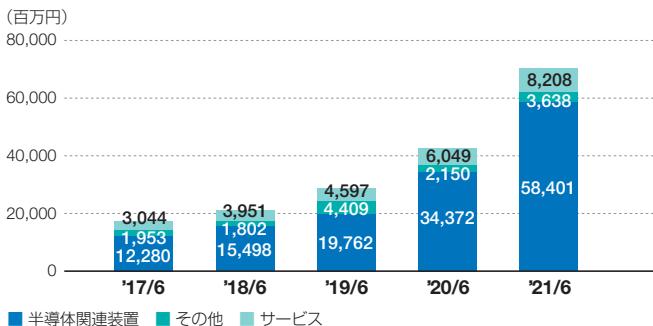
② 売上高/利益

業績は予想を上回り、売上高、利益で過去最高額を5年連続で更新しました。EUV向け製品が牽引し半導体関連装置が大幅増収となり、売上高は700億円を超えました。

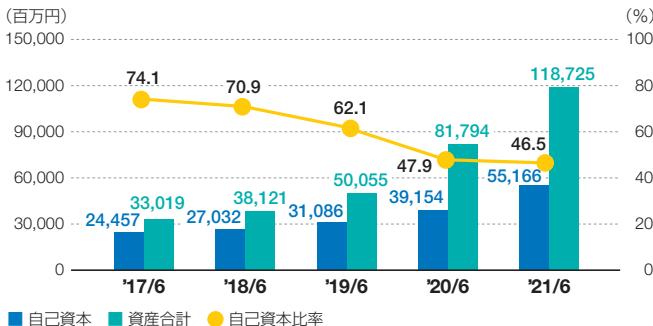
③ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益、前受金の増加などの収入要因が、たな卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出要因を上回りました。

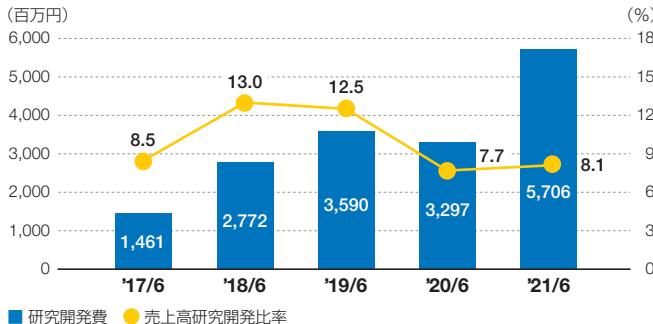
● 製品別売上高



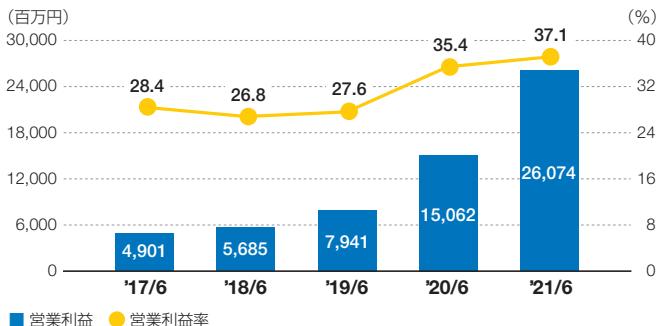
● 自己資本・資産合計・自己資本比率



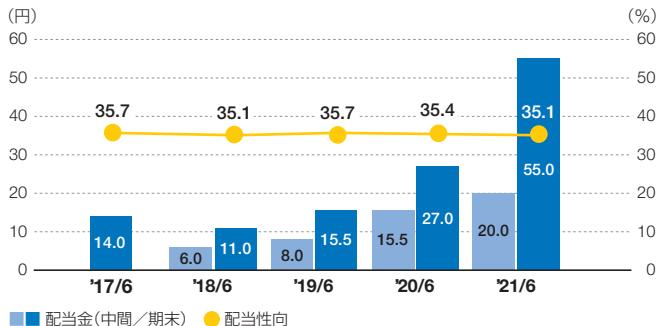
● 研究開発費・売上高研究開発比率



● 営業利益・営業利益率

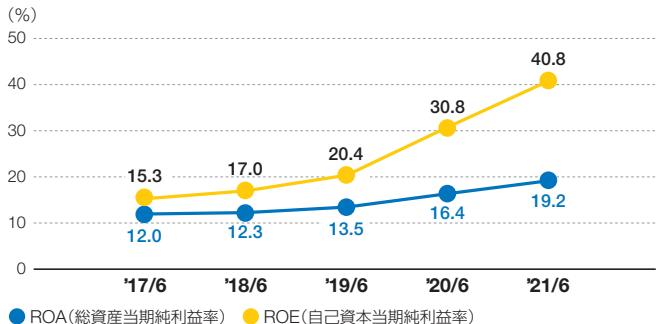


● 1株当たり配当金・配当性向



※ 2017年6月期以降、普通株式1株につき2株の割合での株式分割を2回実施いたしました(2017年4月1日付および2020年1月1日付)。経年比較のため、上記の金額は2017年6月期の期首にこれらの株式分割が行われた仮定で算定しております。
また、2018年6月期より中間配当を実施しております。

● ROA・ROE



※ 2018年6月期の会計方針の変更に伴い、2017年6月期の決算数字を遡り適用し変更しています。

会社概要 (2021年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 529名 単体 328名
お問い合わせ先	045-478-7127 (経営企画室)

株式情報 (2021年6月30日現在)

株式概要

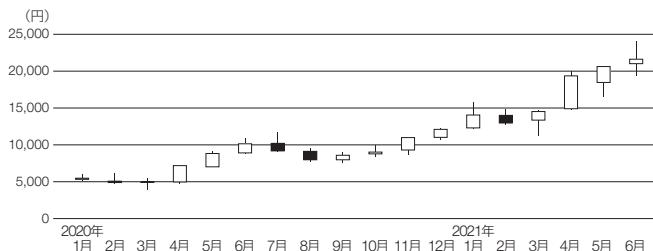
上場市場	東京証券取引所市場第一部
発行済株式総数	94,286,400株
株主数	29,905名
大株主一覧	

	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6,692	7.42
内山 靖子	4,006	4.44
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3,752	4.16
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS	3,696	4.09
内山 洋	3,483	3.86
BBH FOR UMB BANK, NA - WCM FOCUSED INTERNATIONAL GROWTH FUND	3,420	3.79
株式会社三菱UFJ銀行	3,008	3.33
内山 秀	2,788	3.09
前田 せつ子	2,587	2.86
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	2,118	2.34

(注)1. 当社は、自己株式を4,108千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株価の推移



役員 (2021年9月28日現在)

取締役会長 楠瀬 治彦	社外取締役 海老原 稔
代表取締役社長 岡林 理	下山 隆之 三原 康司 上出 邦郎
専務取締役 森泉 幸一	常勤監査役 浅見 公一
常務取締役 内山 秀	監査役 石黒 美幸 出雲 栄一
取締役 関 寛和	

株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。



(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本支店でお支払いいたします。